LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI08_1+6+1_0,80_17.5

8 - Lagen

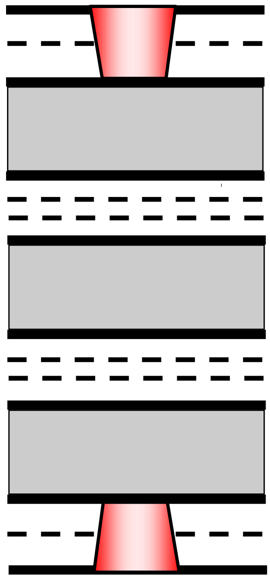
Kerne: 0,10 mm Cu 17/17 µm

WE-Artikel Nr.:

1 + 6 + 1

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	WE	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
	TOP/VS	Folie	12 µm	1)	12	
				1 x 1080	66	
	2		17,5 µm		16	
		0,100 mm			100	
	3		17,5 µm		16	
				2 x 1080	134	
	4		17,5 µm		16	
		0,100 mm			100	
	5		17,5 µm		16	
				2 x 1080	134	
	6		17,5 µm		16	
		0,100 mm			100	
	7		17,5 µm		16	
				1 x 1080	66	
	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material: 820

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**0,80**	+/-	0,06	mm	Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	0,88	+/-	0,09	mm		
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	0,94	+/-	0,11	mm		
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:	

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	8+